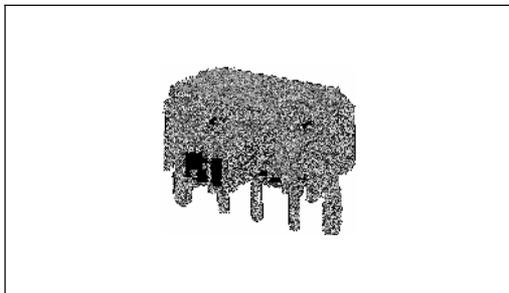


撥動開關

[SK 側操作/圓型滑塊]

# 承 認 書



## 特点：

- DIP 封装/黑色, 适用于小型机器的单向式。
- 外形: 4.4mm × 8.6mm
- 材质: 合金/热塑性塑料 (PA)  
雙檔位、圓形滑塊避免误操作。

## 用途：

- 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类相关产品。

## 東莞市碩方電子科技有限公司

[DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD]

## 樣品承認專項 [Sample Approval Drawing]

客戶名稱 [Customer]	客戶料號 [Customer P/N]
部品型號 [Parts Model] SK-12D02 B 級指標	技術參數 [Parameters] 環境に優しい材料

承認單位 [3 Research Institute]:

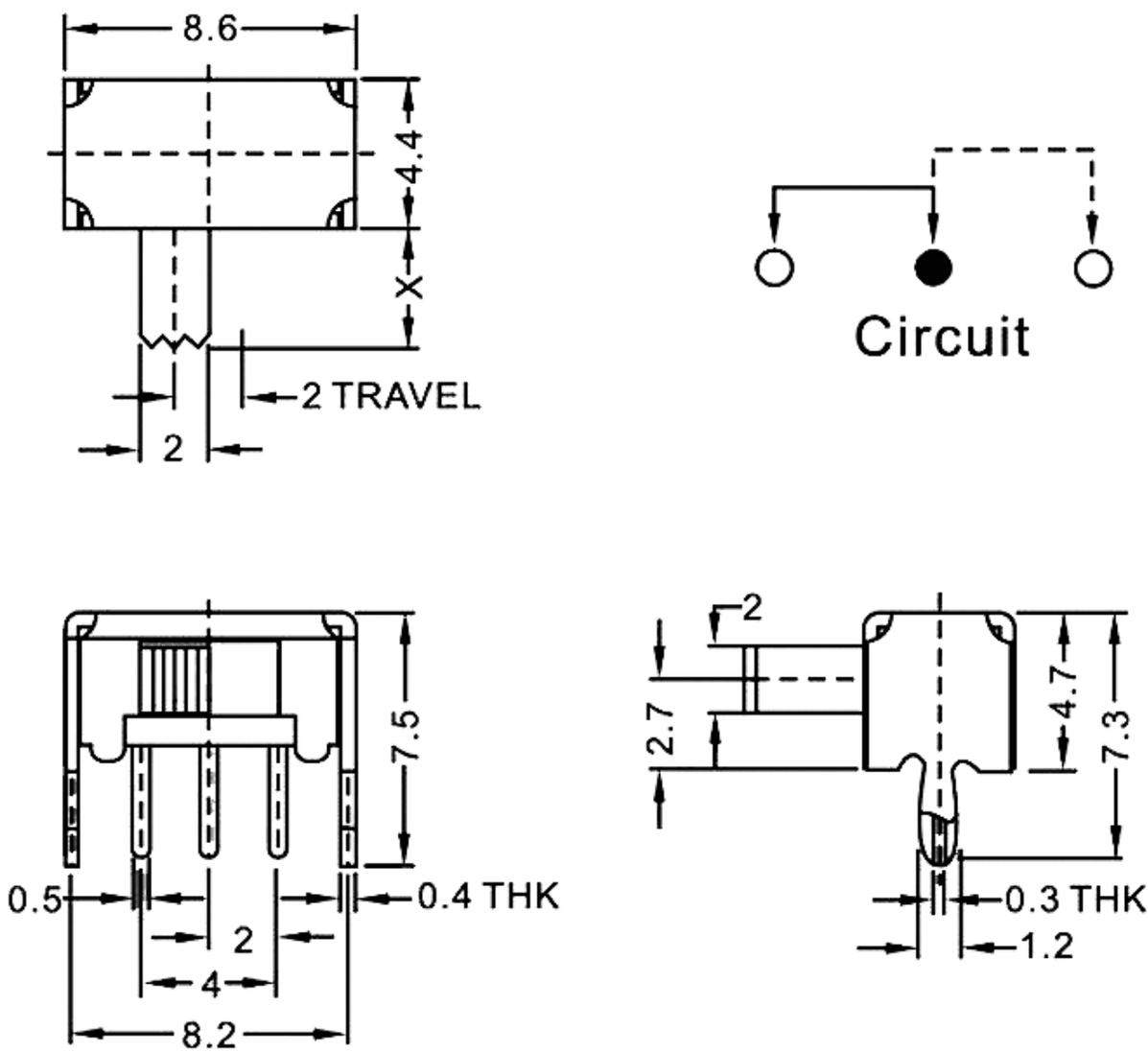
工程部 [R&D]	品保部 [Q C]	採購部 [Purchase]

客戶判定 [Customer Determine]:

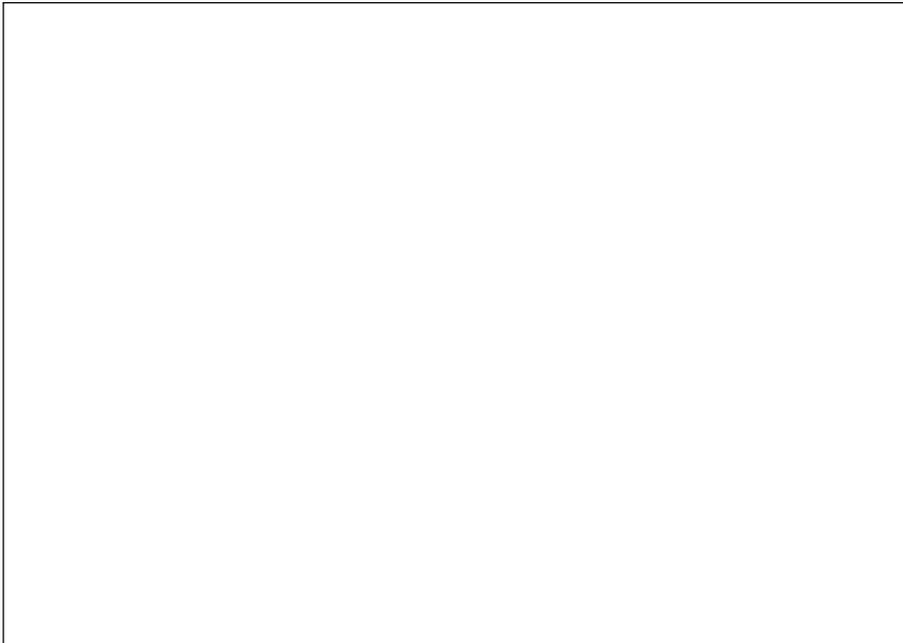
工程部 [R&D]	品保部 [Q C]	採購部 [Purchase]
[章 承]	[章 承]	[章 承]

說明 [Remnrk] 此物料參數技術指標為 B 級產品指標。

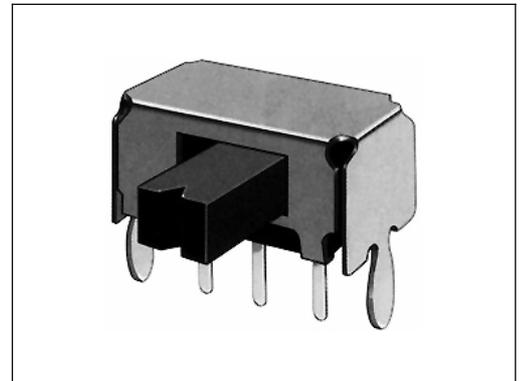
■ 外形图

No.	尺寸
1	 <p>The technical drawings include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A top view showing a width of 8.6 and a height of 4.4. A dimension 'X' is indicated for the lower section, and '2 TRAVEL' is noted for the internal mechanism. A width of 2 is shown at the bottom.</li> <li>A side view showing a total height of 7.5 and a width of 8.2. It includes a detail of a 0.4 THK (thickness) section with a width of 2 and a depth of 0.5.</li> <li>Another side view showing a height of 7.3 and a width of 1.2. It includes a detail of a 0.3 THK section with a width of 2 and a depth of 2.7.</li> <li>A circuit diagram labeled 'Circuit' showing three terminals: two open circles and one solid black circle.</li> </ul>

■ 电路图[A向]



■ 端子[引脚]



## ■ 使用参数

项目		等级			
		A 级 [产品]	B 级 [产品]	C 级 [产品]	
电气性能	初期接触电阻	80mΩ max.	60mΩ max.	60mΩ max.	
	绝缘电阻	100mΩ min. 100V DC Skey/PD: 50mΩ min. 100V DC			
	耐电压	500V AC for 1min	450 V AC for 1min		
机械性能	极限操作行程		2.0mm		
	操作强度	工作方向	1P2T		
		拉引方向			
	耐振性能		10N	6N [条件: 全振幅 1.5mmX, Y, Z 方向 2H]	
	焊接耐热	手工焊接	350±10°C 3+ <sup>1</sup> S		300±10°C 3+ <sup>1</sup> S
		波峰焊	260±10°C 10+ <sup>3</sup> S	230±5°C 10+ <sup>3</sup> S	230±5°C 10+ <sup>3</sup> S
回流		無數據	無數據	無數據	
最大额定 [电阻负荷]		50V 20mA	30V 0.2A	30V 0.2A	
使用温度范围		-10°C to +60°C			
耐久性能	无负荷寿命	12,000 Cycles	10,000 Cycles	無數據	
	负荷寿命 [额定负荷]	10,000 Cycles 50mΩ max.	8,000 Cycles 30mΩ max.	無數據	
耐环境性能	耐寒性能	-40±2°C for 96h	-20±2°C for 96h		
	耐热性能	85±5°C for 96h	75±5°C for 96h		
	耐湿性能	40±2°C, 90 to 95% RH for 96h			

## ■ 焊接条件

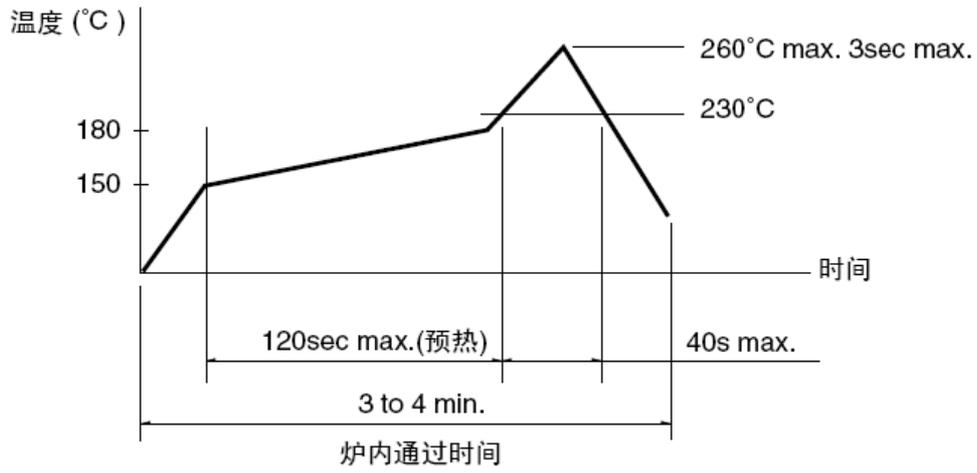
### 手焊式

项目	条件
焊接温度	350°C max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

### 回流焊

[适用表面贴装型产品]

1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2的CA (K) 或CC (T) 测量位置在焊接连接部 (锡/铜箔面)。
3. 固定方式: 采用耐热胶带。
4. 温度分布: (图 2.15)

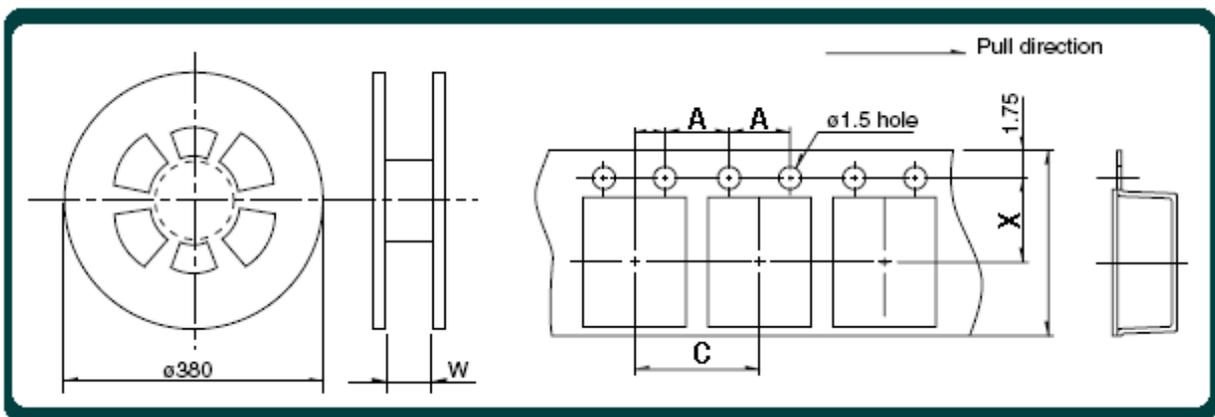


2. 15

浸焊式

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2次以下

■ 自动插入式贴纸包装



注: A, C, W, X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸]包装请与本公司联系。